

本论坛重点探讨以 SiC 和 GaN 等为代表的第三代半导体器件产品，深入讨论及解读该类功率器件供应链、技术与市场等热潮话题。

## 第三代半导体行业论坛

## The 3rd Generation Semiconductor Forum

论坛赞助商：



### 英飞凌碳化硅以及驱动关键技术

10:00

- 郝欣，零碳工业功率事业部大中华区首席工程师  
英飞凌科技（中国）有限公司  
Infineon Technologies China Co., Ltd.

10:20

### 创新测试技术来加速车规级功率半导体的市场化进程

- 程加昌，设备事业部产品线总监  
杭州飞仕得科技有限公司  
Hangzhou Firststack Technology Co., Ltd.

10:40

### GaN 相关新产品及系统介绍

- 周劲，副总经理  
罗姆半导体（上海）有限公司  
ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

11:00

### 第三代半导体 GaN - 未来新能源设计的创新驱动力

- 方舟，MOSFET 产品线高级应用经理  
安世半导体（中国）有限公司  
Nexperia

11:20

### 面向中大功率应用的三菱电机最新 SiC 功率模块

- 胡博  
三菱电机机电（上海）有限公司  
Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd.

11:40

### 创新的车规级 SiC 功率模块封装技术与材料

- 李猛，高级应用工程师  
赛米控丹佛斯  
Semikron Danfoss

12:00